

技術詞彙表

「AAU」	指 有源天線單元	有源天線單元是一種無線基地台組件，其將天線元件與射頻功能整合在一起，用以傳輸和接收移動通訊信號。
「ACF」	指 異方性導電膠膜	異方性導電膠膜是一種含有導電顆粒的黏著膜，能在單一方向上提供電氣連接，同時在其他方向上保持絕緣。
「AES」	指 主動式靜電感應技術	主動式靜電感應技術是一種專為在製造過程或設備運作期間，主動監測、控制或消除靜電電荷而設計的系統。
「AOFT」	指 柔性基板薄膜觸控	柔性基板薄膜觸控是一種觸控傳感器架構，其主要導電層與感測層皆整合於薄膜基板上。
「AOI」	指 自動光學檢測	自動光學檢測是一種基於機器視覺的檢測技術，用於自動識別製造零件中的缺陷或異常。
「AI」	指 人工智能	人工智能指使電腦系統能夠執行學習、推理、模式辨識及決策等功能的技術。
「BBU」	指 基帶處理單元	基帶處理單元是一種電信網絡元件，負責處理基帶信號，並控制核心網絡與無線電單元之間的通訊。
「BGA」	指 球柵陣列	球柵陣列是一種表面貼裝集成電路封裝，其底部採用焊球柵陣列，用以與電路板建立電氣及機械連接。
「BMS」	指 電池管理系統	電池管理系統是一種用於監控和管理電池組充電、放電、溫度、安全及性能的電子系統。
「CAF」	指 導電陽極絲	導電陽極絲是一種印刷電路板的失效機制，其特徵是在電壓偏壓與濕氣的作用下，絕緣材料中會形成導電路徑。
「CCD」	指 電荷耦合器件	電荷耦合器件是一種電子影像傳感器，能將入射光轉換為電信號，用於影像擷取及機器視覺應用。
「CNC」	指 計算機數控	計算機數控是一種製造技術，透過預先編程的電腦指令來控制機床的移動與運作。
「COB」	指 板載芯片	板載芯片是一種電子封裝方法，其原理是將裸半導體晶片直接安裝於印刷電路板或其他基板上，並進行電氣連接與封裝。
「COG」	指 玻璃覆晶封裝	玻璃覆晶封裝是一種電子封裝方法，其原理是將集成電路直接安裝在玻璃基板上，通常應用於顯示器與觸控面板領域。
「CPO」	指 共封裝光學器件	共封裝光學器件是一種整合架構，將光學引擎配置在電子交換或處理晶片附近，或與其封裝於同一封裝內，藉此提升頻寬並降低功耗。

技術詞彙表

「DR/FR」	指 近場／遠場	DR和FR分別指針對較短距離與較長距離數據傳輸應用所設計的光學收發器傳輸距離類別。
「DSP」	指 數字信號處理器	數字信號處理器是一種專用處理器，用於執行高速數學運算，以處理、校正及優化數字信號。
「DU」	指 分佈式單元	分佈式單元是無線電接入網絡的組件之一，負責執行即時基帶處理，並將無線單元與集中式單元相互連接。
「EAM」	指 企業資產管理	企業資產管理是一種基於軟件的方法，用於管理組織實體資產的生命週期、維護、利用率及效能。
「ECU」	指 電子控制單元	電子控制單元是一種嵌入式電子系統，用於控制一項或多項電氣或機械功能，尤其是車輛中的相關功能。
「EHS」	指 環境、健康及安全	環境、健康及安全是指用於管理環境影響、職業健康及工作場所安全風險的政策、制度與實務。
「ELIC」	指 每層互連	每層互連是一種高密度印刷電路板技術，可實現多層電路板中任意兩層之間的電氣互連。
「EMI」	指 電磁干擾	電磁干擾是指會干擾或降低電子設備運作或信號傳輸效能的非預期電磁能量。
「EML」	指 電吸收調製激光器	電吸收調製激光器是一種將雷射與電吸收調製器整合在一起的半導體光源，用於高速光信號傳輸。
「ERP」	指 企業資源規劃	企業資源規劃是一套整合式軟件系統，用於管理與協調核心業務流程，包括財務、採購、庫存、生產及供應鏈營運。
「ESG」	指 環境、社會及管治	環境、社會及管治是指用於評估及管理企業對環境的影響、社會責任及公司治理實務的框架。
「EV」	指 電動汽車	電動汽車是指完全或部分由儲存在可充電電池或其他電能儲存系統中的電能所驅動的車輛。
「軟板」	指 柔性印刷電路	柔性印刷電路是一種薄且可彎曲的電路基板，用於在緊湊型或可移動的電子產品中提供電氣連接。
「FPCA」	指 柔性印刷電路組件	柔性印刷電路組件是一種已組裝完成的柔性電路，其中整合了電子元件、連接器或其他功能性零件。
「FTTH」	指 光纖到戶	光纖到戶是一種寬頻網絡架構，可將光纖連線直接延伸至住宅場所。

技術詞彙表

「F5G」	指 第五代固定網絡	第五代固定網絡是一種基於標準的固定網絡架構，旨在提供高頻寬、低延遲且可靠的光纖連線。
「F5G-A」	指 第五代固定網絡增強版	第五代固定網絡增強版是F5G的升級版本，旨在提供更強大的頻寬、連線能力、延遲表現及網絡智能功能。
「GF2」	指 雙面導電層玻璃單層薄膜	玻璃單層薄膜是一種由玻璃層與雙面感應薄膜組成的觸控面板結構，用於偵測觸控輸入。
「GPU」	指 圖形處理器	圖形處理器是一種專為高度並行運算而設計的專用處理器，廣泛應用於圖形渲染、人工智能及高效能運算領域。
「HDI」	指 高密度互連	高密度互連是一種印刷電路板技術，透過採用細線、微孔及高密度佈線，以支援結構緊湊且複雜的電子產品。
「IIoT」	指 工業物聯網	工業物聯網是由相互連線的工業設備、傳感器及軟件系統所組成的網絡，用於收集和交換運作數據，以進行監控、自動化及製程優化。
「InP PIC」	指 磷化銦光子集成電路	磷化銦光子集成電路是一種半導體裝置，能在單一磷化銦晶片上整合多種光學功能，例如發光、調變與偵測。
「IoT」	指 物聯網	物聯網是一種由嵌入傳感器、軟件及連網功能的實體裝置所組成的網絡，使該等裝置能夠收集、交換資料並據此採取行動。
「LCD」	指 液晶顯示	液晶顯示是一種利用液晶來控制光線透射並產生影像的平面顯示器。
「LCM」	指 液晶模組	液晶模組是一種集成式顯示組件，由液晶面板及相關元件(例如背光模組、驅動電路和連接器)組成。
「LPO」	指 線性可插拔光學器件	線性可插拔光學器件是一種光模塊架構，其將數字信號處理器從可插拔光模塊中移除，並採用線性電氣介面，以降低功耗與延遲。
「LRO」	指 線性接收器光學器件	線性接收器光學器件是一種光纖接收器架構，其採用線性電氣介面來傳輸接收到的光信號，且在光模塊內部不進行數字信號處理。
「MES」	指 製造執行系統	製造執行系統是一種軟件平台，用於即時監控、管理及控制工廠現場的生產活動與工作流程。
「MLPCB」	指 多層印刷電路板	多層印刷電路板是一種由多層導電層組成的電路板，各層之間以絕緣材料隔開，用以支援複雜且高密度的電子連接。

技術詞彙表

「MSA」	指 多源協議	多源協議是一種行業協議，據此，多名供應商採用共同的規格，以確保光模塊等產品的互通性與互換性。
「mSAP」	指 改良型半加成法	改良型半加成法是一種印刷電路板製造方法，透過在薄的基底銅層上選擇性地鍍銅，來形成細微的導電線路。
「MPP」	指 微軟筆協議	微軟筆協議是由微軟所開發的一項通訊標準，可讓相容的數字筆與支援觸控的顯示器及裝置進行互動。
「NRZ」	指 不歸零編碼	不歸零編碼是一種二進位信號編碼格式，其利用兩種信號電平來表示資料，且在連續的位元之間不會返回中性電平。
「NTSC」	指 國家電視系統委員會	國家電視系統委員會標準是一項模擬電視與色彩編碼標準，亦常被用作測量顯示器色域的參考基準。
「OECD」	指 經濟合作與發展組織	經濟合作與發展組織是一個致力於推動旨在促進經濟發展、貿易及社會福祉之政策的國際組織。
「OSFP」	指 八通道小型可插拔	八通道小型可插拔是一種高密度、可熱插拔的光模塊規格，支援八條電路通道，用於高速數據傳輸。
「OCA」	指 光學透明膠黏劑	光學透明膠黏劑是一種透明的黏合膜，用於黏合顯示器、觸控面板及保護玻璃等組件，同時能維持光學透明度。
「OCR」	指 光學透明樹脂	光學透明樹脂是一種透明的液態樹脂，用於黏合光學及顯示元件，並減少層間的反射與視覺失真。
「OEM」	指 原始設備製造商	原始設備製造商是指製造產品或零組件，並將其以其他公司品牌進行銷售或整合至產品中的公司。
「OLED」	指 有機發光二極管	有機發光二極管是一種顯示技術，其原理是利用有機電致發光材料在電流作用下發光，因此無需額外的背光裝置。
「OLT」	指 光線路終端	光線路終端是位於被動光網絡服務供應商端的一種設備，負責管理與用戶端光網絡設備之間的通訊。
「ONT」	指 光網絡終端	光網絡終端是一種用戶端設備，用於終結光存取網絡，並將光信號轉換為電子信號，供用戶端使用。
「ONU」	指 光網絡單元	光網絡單元是被動光網絡中位於用戶端的一種裝置，負責將光信號轉換為電子信號，以便分發給終端用戶。
「OTN」	指 光傳送網絡	光傳送網絡是一種電信網絡架構，用於透過光纖傳輸、多工處理及管理高容量的資料流量。

技術詞彙表

「OTU」	指 光信道傳送單元	光信道傳送單元是一種OTN資料幀結構，用於封裝並傳輸包含監控與錯誤校正資料的用戶信號。
「PAM4」	指 四電平脈衝幅度調製	四電平脈衝幅度調製是一種信號編碼技術，透過四種不同的幅度級別，每符號傳輸兩位元，藉此提升數據傳輸容量。
「PC」	指 個人計算機	個人計算機是一種專為個人使用而設計的通用運算裝置，包括桌上型電腦和筆記型電腦。
「PCB」	指 印製電路板	印製電路板是一種含有導電路徑的基板，用以機械性地支撐電子元件並使其在電氣上相互連接。
「PLM」	指 產品生命週期管理	產品生命週期管理是一套用於管理產品信息及相關流程的系統，涵蓋產品生命週期的各個階段，從設計與開發，到製造、服務及報廢。
「PON」	指 無源光網絡	無源光網絡是一種光纖接取網絡，其利用被動式光纖分路器，將單一服務供應端的光線路終端連接至多個用戶端裝置。
「QMS」	指 質量管理體系	質量管理體系是一套由政策、流程及控制措施所構成的結構化框架，旨在確保產品與服務能持續符合品質及法規要求。
「QSFP-DD」	指 四通道小型可插拔雙密度	四通道小型可插拔雙密度是一種高密度、熱插拔的收發器外型規格，支援八條電路通道，用於高速網絡連接。
「RAN」	指 無線電接入網絡	無線電接入網絡是移動通訊網絡中，透過無線基地台及相關設備將使用者裝置連接到核心網絡的那一部分。
「RF」	指 射頻	射頻是指用於無線通訊、信號傳輸及相關電子應用的電磁頻率。
「硬板」	指 剛性印製電路板	剛性印製電路板是一種不可彎曲的電路板，用於機械支撐電子元件並使其在電氣上相互連接。
「SDH」	指 同步數字體系	同步數字體系是一種標準化的光傳輸技術，用於在電信網絡中對多個數字數據流進行多工傳輸。
「SFP」	指 小型可插拔	小型可插拔是一種緊湊型、可熱插拔的收發器外型規格，用於透過光纖或銅纜進行資料傳輸。
「硅光」	指 硅光子學	硅光子學是一項利用硅基材料及半導體製造製程，在集成電路晶片上產生、引導、調變或偵測光信號的技術。
「SMT」	指 表面貼裝技術	表面貼裝技術是一種電子組裝方法，其原理是將元件直接安裝在印刷電路板的表面上。

技術詞彙表

「SONET」	指 同步光網絡	同步光網絡是一種標準化的光傳輸技術，用於在光纖網絡中對多個數字數據流進行多工傳輸。
「SRM」	指 供應商關係管理	供應商關係管理是一種系統的方法，通常透過軟件支援，用以管理供應商信息、績效、風險及採購合作。
「SR/VR」	指 短距離／超短距離	短距離及超短距離是光通訊的分類，適用於相對較短的傳輸距離，通常應用於數據中心或高效能運算系統。
「STM-N」	指 N級同步傳輸模塊	N級同步傳輸模塊是SDH網絡中用於傳輸數字流量的標準化傳輸幀與資料速率層級，其中「N」代表相應的容量等級。
「TFT」	指 薄膜晶體管	薄膜晶體管是一種形成於基板上薄層的電晶體，通常用於控制平面顯示器中的個別像素。
「USI」	指 通用手寫筆聯盟	通用手寫筆聯盟是一項行業標準，旨在實現不同製造商所生產的相容主動式觸控筆與觸控裝置之間的互通性。
「WCS」	指 倉庫控制系統	倉庫控制系統是一種軟件平台，用於協調與控制自動化倉庫設備（例如輸送帶、機器人及分揀系統）的即時運作。
「WMS」	指 倉庫管理系統	倉庫管理系統是一種用於管理倉儲作業的軟件平台，其管理範圍涵蓋庫存、儲存位置、訂單履行以及貨物調度。
「XGS-PON」	指 10G對稱無源光網絡	10G對稱無源光網絡是一種光纖接取網絡，其上下行方向的資料傳輸速率均可達10 Gbps。